

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年4月3日(03.04.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/069527 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 7/20 (2018.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/015326

(22) 国際出願日: 2024年4月17日(17.04.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-160097 2023年9月25日(25.09.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).

(72) 発明者: 大久保 恵介 (OHKUBO Keisuke); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 藪下 諭 (YABUSHITA Satoshi); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 木村 尚弘 (KIMURA Naohiro); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 谷口 徹弥 (TANIGUCHI Tetsuya); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 岩永 有輝啓 (IWANAGA Yukihiro); 〒1057325 東京

都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 越野 美春 (KOSHINO Miharu); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP).

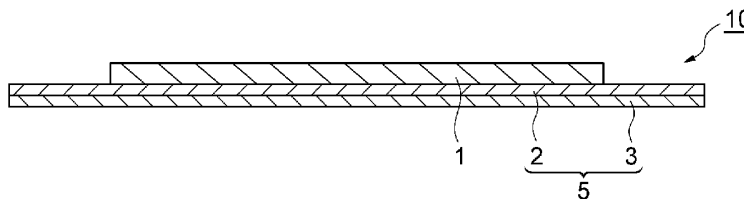
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

(54) Title: DICING/DIE-BONDING INTEGRATED FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム及びその製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a dicing/die-bonding integrated film 10 comprising: a dicing film 5 including a base material film 3 and an adhesive layer 2 provided on the base material film 3; and an adhesive layer disposed on the adhesive layer 2 of the dicing film 5 and composed of a die bonding film 1. The loss tangent of the dicing film 5 at 0°C is 0.15 or less.

(57) 要約: 基材フィルム3及び基材フィルム3上に設けられた粘着剤層2を含むダイシングフィルム5と、ダイシングフィルム5の粘着剤層2上に配置された、ダイボンディングフィルム1からなる粘着剤層と、を備える、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム10が開示される。ダイシングフィルム5の0°Cにおける損失正接は0.15以下である。

[続葉有]

TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）